

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2024-040

彤程新材料集团股份有限公司

关于子公司签订“半导体芯片先进抛光垫项目”合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司上海彤程电子材料有限公司于2024年5月27日与江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会签署《“半导体芯片先进抛光垫项目”合作协议》（以下简称“《合作协议》”），协议备案投资3亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），项目顺利达产后可实现年产半导体芯片先进抛光垫25万片、预计满产后年销售约8亿元。

相关风险提示：

1、本次投资系公司基于长期战略规划及对行业市场前景的判断而做出的谨慎决定，但受市场变化的不确定性及相关政策的影响，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步完善内部管控制度和监督机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

2、本次项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。协议履行期间，存在法律、法规、政策、技术、市场、管理等方面不确定性或风险，同时还可能面临突发意外事件以及其他影响因素所带来的风险等。

3、本次投资建设将会增加公司资金需求，公司将根据投资进度统筹资金安排，合理确定资金来源和支付安排等，以保证该项目顺利实施。

4、本协议中提及的有关投资金额、年销售额等是基于目前情况结合市场环境拟定的初步规划，均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、对外投资概述

基于公司长期发展规划及经营发展需要，公司子公司上海彤程电子材料有限公司于2024年5月27日与江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会签署《合作协议》，拟在江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区(以下简称“华罗庚高新区”)内投资建设半导体芯片抛光垫生产基地，协议备案投资3亿元(最终投资金额以项目建设实际投入为准)，主要从事半导体芯片抛光垫的研发、生产和销售，项目顺利达产后可实现年产半导体芯片先进抛光垫25万片、预计满产后年销售约8亿元。

公司第三届董事会第十三次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司拟签订“半导体芯片先进抛光垫项目”合作协议的议案》，董事会授权公司管理层签署本次投资事项相关的法律文书及办理后续相关手续事宜。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次签署《合作协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对方基本情况

- 1、名称：江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会
- 2、主体类型：地方政府机构
- 3、与公司关系说明：无关联关系

江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，不属于失信被执行人。

三、协议主要内容

甲方：江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会

乙方：上海彤程电子材料有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，甲、乙双方本着互惠互利、合作共赢的原则，就乙方在江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区内投资建设“半导体芯片先进抛光垫项目”达成如下合作协议，以供双方共同遵守。

1、项目概况

“半导体芯片先进抛光垫项目”(以下简称“本项目”)协议备案投资3亿元(人民币，下同)，拟在华罗庚高新区内新建半导体芯片抛光垫生产基地，主要从事半导体芯片抛光垫的研发、生产和销售，项目顺利达产后可实现年产半导体芯片先进抛光

垫 25 万片、预计年销售约 8 亿元。

2、项目公司

乙方应于本协议生效 15 个工作日内，在华罗庚高新区设立彤程电子材料（常州）有限公司（暂定名，以企业登记核定名称为准，以下简称“项目公司”），乙方承诺以该企业为经营主体，负责本项目后期实施。

3、项目场地及建设

甲方协调第三方公司向项目公司出租厂房，供项目公司使用。甲乙双方约定租期 10 年（租期以实际租赁时间为准），租赁期间的租金不超过第三方公司出具的指导价，具体租赁条款由相关方另行签署协议约定。

4、其他

本协议未尽事项，由甲、乙双方友好协商，以签订补充协议的方式予以确定。补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议经甲、乙双方代表人签字、加盖公章完毕后即生效。

四、本次投资的目的及对公司的影响

本次投资将进一步推进公司在半导体材料领域的业务拓展和战略布局，扩展彤程电子作为电子化学品平台公司的产品广度，半导体芯片先进抛光垫作为半导体制程中重要的材料之一，具有广阔的市场规模，目前在研产品性能体现出较强的技术领先性，产品量产后可为公司提供新的业务增长点，持续提高公司盈利能力，为股东创造更大的价值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次项目投资及《合作协议》的签订，预计不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响，对公司后期经营业绩的影响将根据具体项目的推进和实施情况而定。

五、风险提示

1、本次投资系公司基于长期战略规划及对行业市场前景的判断而做出的谨慎决定，但受市场变化的不确定性及相关政策的影响，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步完善内部管控制度和监督机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

2、本次项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。协议履行期间，存在法律、法规、政策、技术、市场、管理等方面不确定性或风险，同时还可能面临突发意外事

件以及其他影响因素所带来的风险等。

3、本次投资建设将会增加公司资金需求，公司将根据投资进度统筹资金安排，合理确定资金来源和支付安排等，以保证该项目顺利实施。

4、本协议中提及的有关投资金额、年销售额等是基于目前情况结合市场环境拟定的初步规划，均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2024年5月28日